

BST-21503A 150 г Паста для пайки высокого качества для светодиодной BGA SMD PGA Top Паяльная паста Flux Grease

Описание продукта:

100% brandnew и высокое качество !!

Флюс Rosin используется для облегчения пайки.

Он очищает и предотвращает окисление металлов, что позволяет припоям создавать прочные, длительные механические и электрические связи.

Он также действует как смачивающий агент, увеличивая поток припоя и эффективность процесса пайки.

Идеально подходит для мобильных телефонов, ПК-карт и других сложных электронных струйных флеш-сварки.

Характеристики:

Продукт: BST-21503A

Точка плавления: 60 °C

Вес: 150 г / шт.

PRODUCT DISPLAY



PRODUCT DETAILS



Name: Soldering Paste

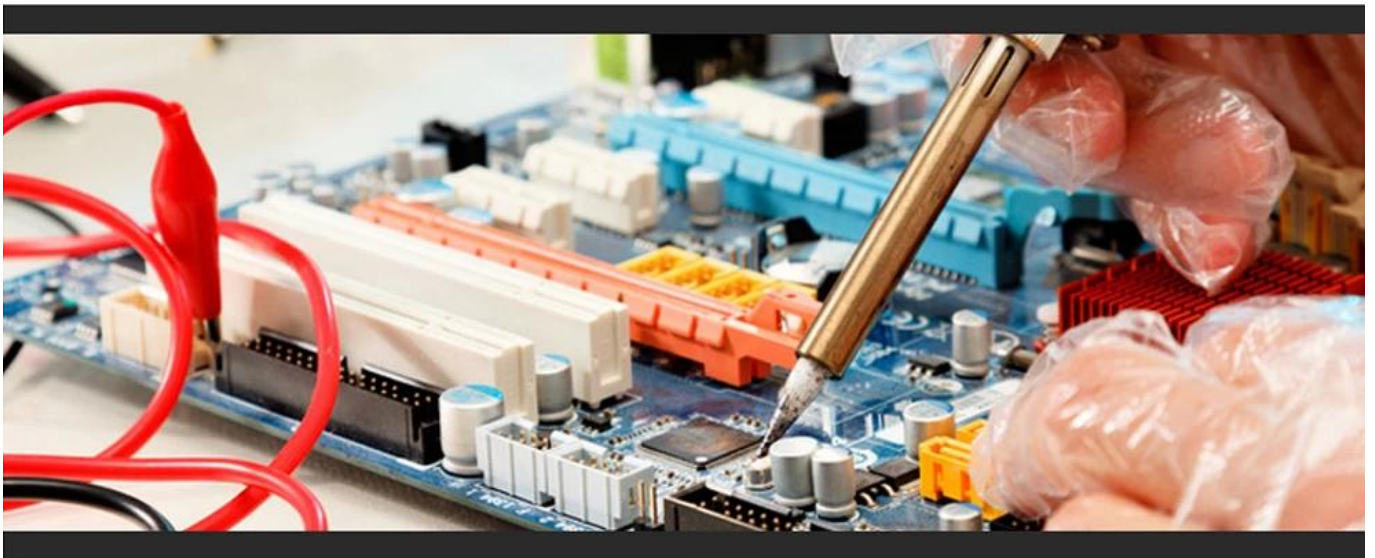
Size: $\Phi 80 \times 45\text{mm}$

Composition: Solder powder, resin

Model: BST-21503A

Weight: 100g

Melting point: 60°C





- ▲ Stable performance, Not volatile, long life cycle, the amount of province;
- ▲ Non-toxic non-irritating odor, the use of safe and reliable;
- ▲ The IC and PCB are not corrosive
- ▲ Its boiling point is only slightly higher than the melting point of solder.

Features: Solder melting at the time of soldering begins to boil endothermic vaporization, which can be maintained at this temperature using IC and PCB temperatures. In the demolition of the chip with a lot of solder paste, it melts fast, you can flow to the BGA chip below. Rosin is solid without solder paste convenient.

PRODUCT PHOTOGRAPH



